

加賀FEI株式会社

〒222-8508 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目100番45 新横浜中央ビル www.kagafei.com/jp/

新価値創出の ワンストップパートナー。

私たちは時代の変化に素早く対応しつつ、そして変わらないサービスをお客様に提供していきます。 世界でもユニークなワンストップ提案型のグローバルエレクトロニクス商社として、 お客様の製品価値を最大限に高めていくために、変えていくこと、決して変えないこと。 "加賀FEI"にご期待ください。

ご挨拶



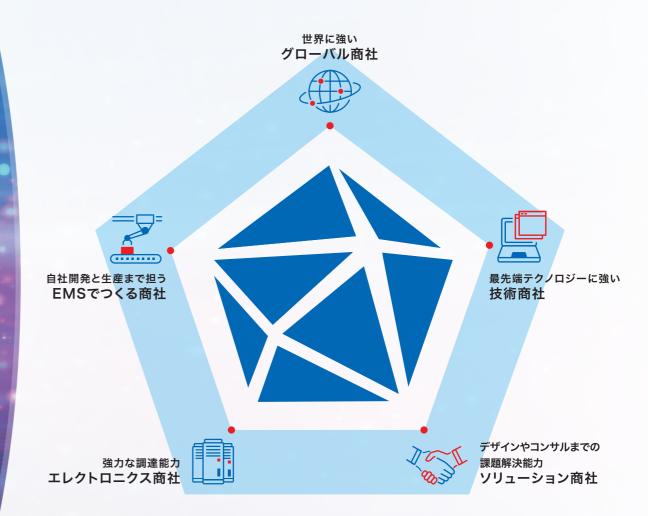
わたくしたち加賀FEIは、かつての半導体中心の電子部品を扱う技術商社から、企画・技 術開発を伴うお客様のモノづくりに携わり、またお客様のDX化推進に貢献するソリュー ション提案も行う創社への変革を通じて、人・もの・ノウハウを成長させてきました。

世界の情勢を鑑みますと、政治・経済の急速な変動や、環境・人口などの長期的な問題ま で、乗り越えなければならない課題が日々顕在化しています。また、Alなどのテクノロジー の発展と普及は、人手不足、防災、医療など、人類に大きなメリットをもたらすと同時に、社 会的なリスクをはらんでいます。

このような予測困難な中で国内外の課題に取り組まれているお客様を通して、わたくした ち加賀FEIが、デジタルテクノロジーはもとより多角的な視点と発想力で社会を豊かにし てまいります。

"もっと頼れる" 加賀 FEI にご期待ください。

代表取締役 社長執行役員 塚本 剛



会社概要

商号	加賀FEI株式会社(英文名:KAGA FEI Co., Ltd.)
設立	1952年5月2日(昭和27年)
資本金	48億7,768万3,581円(発行済株式総数2,663万1,972株)
従業員	950名(海外グループ会社含む)
事業内容	電子デバイス製品の設計・開発および販売
	● 自動車、AV機器、通信機器、情報処理機器向けなどの民生用・産業用電子デバイス製品の販売 ● アプリケーションボードの開発、設計、販売 ● マイコンの民生用・産業用 用途別組込みソフトの開発および販売 ● IoT無線通信モジュールの開発および販売 ● カスタムSoCなどの開発、設計受託および技術サポート
代表者	代表取締役 社長執行役員 塚本 剛

最先端技術が得意技。最新分野がフィールドです。

セキュリティ

あらゆるものがつながれば、そこにはこれまでにない新たな価値が生まれます。 さあ新たなビジネスを始めませんか?

加賀FEIは、IoTをはじめとするデジタル社会の新しいビジネス創出の可能性を、お客様とともに追求し、実現してまいります。



5G

産業や暮しを大きく変革する5Gの普及に向け、IoT、ネットワーク、サービス構築など多角的に貢献。



AI

組込み機器へのAI導入から本格的なクラウドAI活用まで、企画から量産までの全フェーズに豊富な実績。



独自の暗号技術やセキュアなデバイスなど、ソフト・ハード両面の先端技術で、デジタル時代の信頼をサ



ロボティクス

先端デバイスや先端ソフトウェア技術を活用し、産業ロボットや生活支援ロボットの開発を支援。



エネルギー

省エネを実現するパワーデ バイスやスマートハウスを 実現する多用な取り組み。



次世

次世代自動車のテーマであるCASEに対し、映像処理、 情報通信、セキュリティ等の 技術ある実績で貢献。



モビリティ

CASE

IoTによるデータ収集、人・ クルマ・インフラの高度な通 信を通じ、モビリティ社会へ の変革を推進。



スマート工場



__ _ _ _

現場の人手不足対策や競争 力向上のため、工場IoTや 産業ロボットの実現を通じて ものづくり改革を支援。





モノからサービスへ。 モノからコトへ。 ビジネスシフトをサポートします。

Hardware

Support

市場や産業構造が大きく変化していく今日。モノからコトへ。

お客様はハードウェアからサービスプロバイダーへと転換を進めています。

私たちは、お客様のそうした動きに応えるべく、



KAGA FEI



市場や産業構造が 大きく変化していく今日。モノからコトへ。



業界トップレベルの技術力とカスタム対



多品種・小ロットにも対応できるフレキシブ ルな生産体制を確立。

半完成品から完成品まで、お客様に代わり、 ご希望の場所でカタチにいたします。



込みサービスも提供しています。





コンサルティング

お客様のアイデアやコンセプトをもとに、 ハード、ソフトにかかわらず、組込み製品の 企画から要求仕様、要素選定、量産までをコ ンサルティング。企画から量産までトータル

世界中の優れたデバイスを安定調達します。

主な取り扱い製品

▶ 加賀電子グループ製品



加賀FFI株式会社

無線モジュール "CONTINECT Wireless solution" Bluetooth® Low Energyモジュール ·Wireless LANモジュール

8.7 Gスクラユーフェラー 組み込み機器向けHMI開発オーサリングツール "CGI Studio" "UI Conductor" ・フォント描画エンジン "Higlyph





富十通株式会社

・ソフトウェア ・ソリューション&サービス ・コンピュータブラットフォーム

エフサステクノロジーズ株式会社

・サーバー・ストレージ ·ネットワーク機器 ·ソフトウエア

株式会社モバイルテクノ

·無線 / 画像関連の設計 ·評価 ·シュミレーションサービス、コンサルティング

FDK株式会社

・電池(ニッケル水素 / リチウム / アルカリ) ・各種モジュール

富十诵フロンテック株式会社

·手のひら静脈認証 ·RFIDタグ / リーダライタ

socionext

株式会社ソシオネクスト

Solution SoC(ASIC) ·ASSP(特定用途向け) ·共通技術 ·サービス



RAMXEED株式会社 ·システムメモリ (FeRAM, ReRAM, RFID)

バッテリーレスソリューション



富士電機株式会社

·電子デバイス(IGBT、SiCデバイス、パワーMOSFET、電源制御用IC等) アクトリーオートメーション(低圧インバータ、プログラマブルコントローラ等) 電源ソリューション(無停電電源装置、スイッチング電源等)



富士電機機器制御株式会社

・電磁開閉器、マニュアルモータスタータ等 配線用遮断器、漏電遮断器、サーキットプロテクタ等 ・操作表示機器、制御リレー、安全機器等

住友電気工業株式会社

・光デバイス(光トランシーバー)



FCLコンポーネント株式会社

・リレー・タッチパネル・サーマルプリンタ キーボード / ポインティングデバイス ·KVMソリューション ・センサー(非接触型バイタル感知技術、非接触型異常振動検知技術)

新光電気工業株式会社

·半導体パッケージ ·リードフレーム ·ヒートスプレッダ ·IC用インタボーザー ·モジュール ·静電チャック ・モーターコア ・金型部品 ・カーボンナノチューブ高熱伝導シート



FICT株式会社

·高多屋ブリント基板 ·高密度ビルドアップ基板 ·ハイブリッド基板 ・半導体パッケージ基板 ・プリント基板設計、シミュレーション



NJコンポーネント株式会社

・コイル製品/フェライト ・積層パワーインダクタ ・圧電製品

NTTデバイスクロステクノロジ株式会社

・雷子機器等の設計、解析、シミュレーションおよびコンサルティングサービス



エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

·Smart Data Platformサービス ·Things Cloud® (IoT Platform Service)



オータックス株式会社

·DIPスイッチ ·操作用スイッチ ·コネクター ·金属加工製品



カルテック株式会社

·光触媒原材料 並びに応用製品



キヤノンマーケティングジャパン株式会社



サン電子株式会社

・スマートグラス ・ルーター ・センサー



ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社



株式会社TRIPLE-1

マイニング用LSI ・ローカル5G基地局



トレックス・セミコンダクター株式会社

·DC / DCコンバータ ·電圧レギュレータ ·電圧検出器



株式会社ネットビジョン



株式会社PFU

・セキュアインフラ構築および運用サービス



PicoCELA株式会社

・企業向けWi-Fiメッシュ+アクセスポイント機能搭載 ・エッジコンピューター製品

PicoCELA



株式会社BONX ·グループ通話ソリューション ·ウエアラブルデバイス



Master Visions株式会社 ·360度自由視点映像



ユーロフィンFQL株式会社

·電子部品·電子機器の信頼性評価、故障解析 ·各種材料分析、環境分析



海外製品



AAC Technologies

·MEMSセンサ (MEMS Mics / Barometric Pressure Sensors /

スピーカ (Speakers / Car Audio System) ・ハブティクス (Actuators / IC Driver) ·小型レンズ (Optical Lenses / Camera Modules)



株式会社AFSW

・ファウンドリサービス



Allegro MicroSystems, Inc.

・磁気センサーIC(TMR, Hall) ·パワーIC(モータードライバ、パワーマネージメントIC、LEDドライバ)



Ambiq Micro Inc.

·超低消費電力マイコン

Amkor

株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン

·パッケージングサービス ·テストサービス ·設計サービス



ams-OSRAM AG.

·LED(紫外~可視~赤外)、Laser(青色、緑色、赤外) ·Sensor(光センサー、3Dセンシング、LiDAR、位置センサー) ·Mixed-signal カスタムデバイス



セレスティカ・ジャパン株式会社 ・サーバ、ストレージ、ネットワークのホワイトボックス製品、FMS



Cirrus I ogic. Inc.

·オーディオ用 DSP、アンプ、D / Aコンバータ、 A / Dコンバータ、コーデック



Delta Electronics, Inc.

·AC / DCアダプタ



Diodes incorporated ・汎用アナログ、ディスクリート、タイミングIC、電源IC、ロジックIC



DOMINANT Opto Technologies Sdn. Bhd.

·可視LED(車載 内·外装、産業、民生用途)、赤外LED



Elec & Eltek International Co., Ltd

・低層~高多層プリント基板 ・ビルドアップ基板 金属基板 ·Rigid-Flex PCB



Einno Semiconductor

·高出力·高性能 パワーIC、パワーモジュール(SiP) (Industrial Grade, AFC-Q100)



■ ELLINGTON fff Guangdong Ellington Electronic Technology ・低層~高多層プリント基板 ・ビルドアップ基板 ・アルミ基板

EverPro Technologies Company Ltd.

・アクティブ光ケーブル(USB, HDMI, DVI, Display Port. 他) ・トランシーバ(SFP+, QSFP, etc) & 光ケーブル(ガラスファイバ OM2/3)



everpro

Glory Faith (Hong Kong) PCB Co., Ltd

·片面基板 ·低層プリント基板 ·金属基板



IDEMIA France SAS

・自動車向けコネクテッドンリューション ・デジタルキー / NFCカードキー / テレマティクス・インフォテイメント向けeSIM



IntelliGo Technology, Inc.

·AIノイズキャンセルIC ・AIノイズキャンセル / AIビームフォーミング / エコーキャンセル / 音声認識 / 話者方向認識



InvenSense, Inc.

・モーションセンサー ・マイクロフォン ·圧力センサー



·高光束可視光LED(照明、民生)

Lumileds LLC

MediaTek Inc.

赤外LED、紫外LED

・車載用途向け画像処理プロセッサ



Richtek Technology Corporation

·5G / Wi-Fi7·Wi-Fi6E 通信用IC、Internet of Things IC

·各種DCDCコンバーター、LDO、パワーマネジメントIC ·LEDドライバー、BLDCモータードライバ、USB Type-C & PDソリューション ·Class-D Audio Amp



SkyHigh Memory Limited SLC NAND, eMMC, MCP

Sunny Japan

·車載田米学部品

·光学部品 ·カメラモジュール

会 舜宇车载光学

Ningbo Sunny Automotive Optech Co., Ltd.

Zheijang Sunny SmartLead Technologies Co., Ltd.

·車載用カメラモジュール

Thundercomm

Thundercomm Technology Co., Ltd. ·自動車、モバイル、および IoT 向け Snapdragon™ SOM(System on Module)製品 ·Snapdragon™SOMを用いた受託開発案件(ソフトウェア、ハードウェア、クラウド開発)

TIANMA

Tianma Microelectronics Co., Ltd

·液晶パネル

7-通客微電

通富微電子股分有限公司 (Tongfu Microelectronics Co., Ltd.) ・フルターンキーサービスのプロバイダー、多様なパッケージングサービスの提供

-ドフレーム(FCQFN / QFN / LQFP / TSSOP / SOT / TO…)

·基板(BGA / LGA / FCBGA / 2.5D / SIP) ·ウェーハレベル (ファンイン/ファンアウト/ゴールドバンプ)



・水晶振動子、発信器、近接センサー

TXC Corporation

VIA Technologies, Inc. ·ARM系およびx86組み込み基板およびシステム



VIA Labs, Inc.

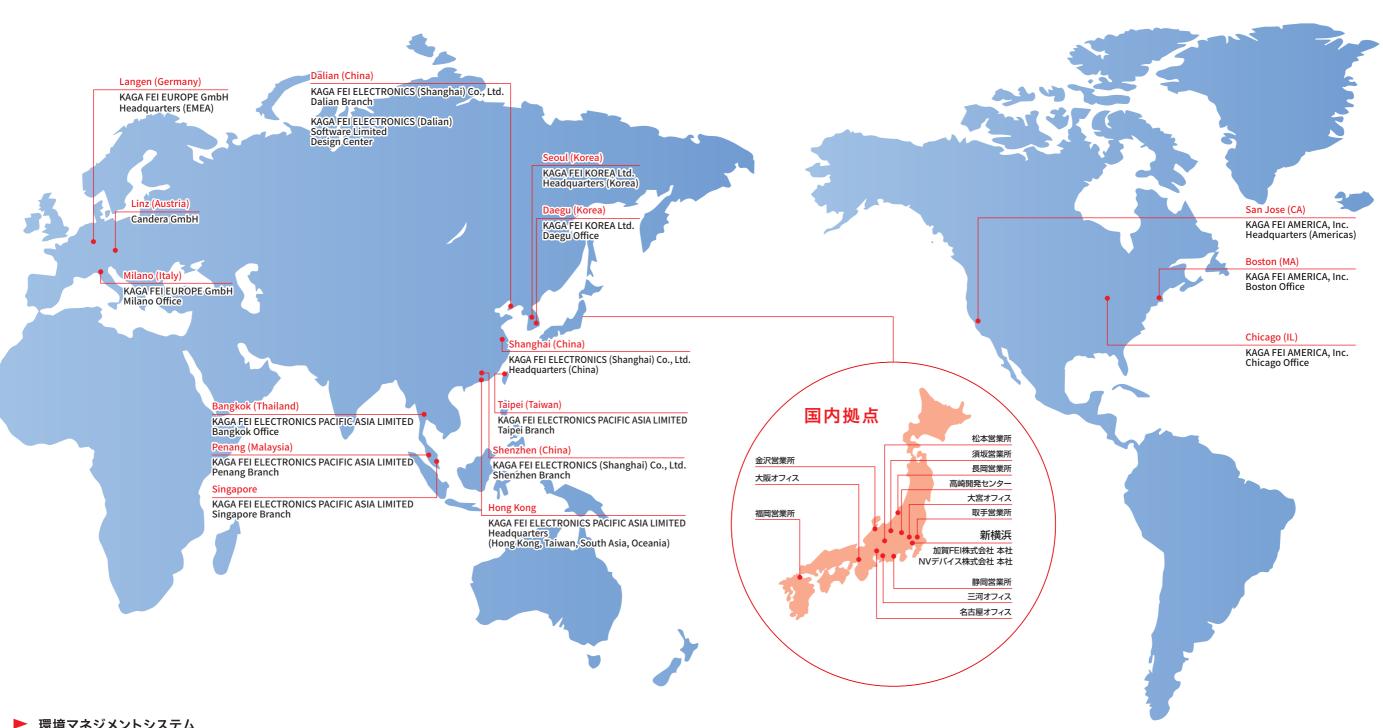
・USB2.0/3.2Gen1&2 ハブIC/USB4 エンドポイントIC ・タイプC PDコントローラ、データスイッチ、eマーカー、リドライバ ·SATA-USB変換ブリッジ、PCIe-USBホストコントローラ

8



WithSecure Corporation ·エンドポイントセキュリティ(EPP/EDR)

日本でも、世界でも私たちはパートナーであり続けます。



環境マネジメントシステム

当社は、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しており、地球環境に優しい電力消費量の少ない製品などの開発・提案や、 製品含有化学物質の適正管理などを行っています。

また、各拠点において省エネルギー、省資源、廃棄物削減、資源リサイクルなどを推進するほか、脱炭素化、生物多様性保全、地域社会に根 ざした環境社会貢献への参画、支援などに取り組んでいます。





審査機関:株式会社日本環境認証機構(JACO) 登録番号: EC18J0025 認証取得日: 2001年3月14日

対象拠点と認証取得日(関係会社を含む)

本社	2001年 3月14日
国内営業拠点	2023年 12月26日
中央物流センター	2001年 3月14日
高崎開発センター	2023年 1月11日
NVデバイス株式会社 本社	2008年 4月 9日
NVデバイス株式会社 相模原事業所	2009年 3月11日